

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年7月3日(03.07.2025)



(10) 国際公開番号

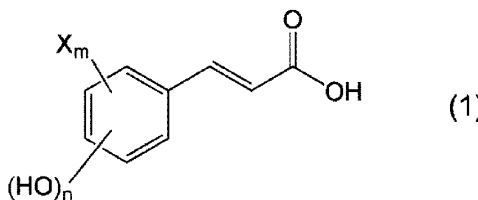
WO 2025/142768 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) B23K 26/53 (2014.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/045138
- (22) 国際出願日: 2024年12月20日(20.12.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-222778 2023年12月28日(28.12.2023) JP
- (71) 出願人: 東京応化工業株式会社(TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 (JP).
- (72) 発明者: 大久保 明日香 (OKUBO Asuka); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 (JP). 木下 哲郎(KINOSHITA Tetsuro); 〒2110012 神奈川県川崎市中原区中丸子150番地 東京応化工業株式会社内 (JP).
- (74) 代理人: 弁理士法人薫風国際特許商標事務所, 外(KUNPU PATENT & TRADEMARK, P.C. et al.); 〒1080014 東京都港区芝四丁目10番5号6階 (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(54) Title: PROTECTIVE FILM COMPOSITION FOR DICING, WAFER MANUFACTURING METHOD, AND WAFER PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: ダイシング用保護膜組成物、ウエハの製造方法、及びウエハの加工方法



(57) Abstract: Provided are: a protective film composition for dicing that contains an ultraviolet absorber that includes a compound (1) represented by formula (1), a water-soluble resin, formate ions, and water, the formate ion content being 300 - 6000 ppm by mass; and a wafer manufacturing method and a wafer processing method utilizing same. (In the formula, X represents a hydrogen atom or -OR¹, R¹ represents a substituted or unsubstituted alkyl group with a carbon number in the range 1-5, n represents a number in the range 1-5, and m represents a number in the range 0-4.)

(57) 要約: 下記一般式(1)で表される化合物(1)を含む紫外線吸収剤と、水溶性樹脂と、ギ酸イオンと、水と、を含有し、ギ酸イオンの含有量が、300～6000質量ppmであるダイシング用保護膜組成物、並びに、これを用いたウエハの製造方法及びウエハの加工方法を提供する。(式中、Xは、水素原子、-OR¹を表す。R¹は、置換又は無置換の炭素数1～5のアルキル基を表す。nは、1～5の数を表し、mは、0～4の数を表す。)

[続葉有]

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）